

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月17日(17.09.2020)



(10) 国際公開番号

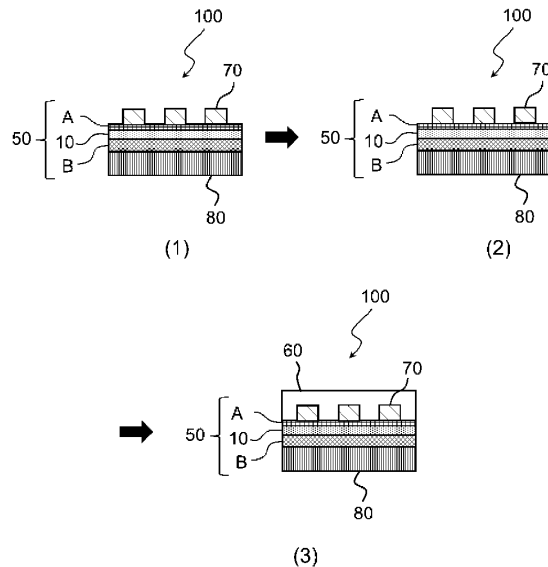
WO 2020/184199 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/12 (2006.01) C09J 133/00 (2006.01)
H01L 23/29 (2006.01) C09J 175/04 (2006.01)
H01L 23/31 (2006.01) C09J 183/04 (2006.01)
C09J 123/00 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)
C09J 125/04 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/008007
- (22) 国際出願日: 2020年2月27日(27.02.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-046792 2019年3月14日(14.03.2019) JP
- (71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町7 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 三浦 徹(MIURA Toru); 〒4570801 愛
知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化
学東セロ株式会社内 Aichi (JP). 栗原 宏
嘉(KURIHARA Hiroyoshi); 〒4570801 愛知県
名古屋市南区丹後通2-1 三井化学東
セロ株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法

[図2]



(57) Abstract: An electronic device manufacturing method comprising at least: a preparation step for preparing a structure (100) comprising an adhesive film (50) that is provided with a base layer (10), an adhesive resin layer (A) provided to a first surface (10A) side of the base layer (10) and for temporarily fixing an electronic component (70), and an adhesive resin layer (B) provided to a second surface (10B) side of the base layer (10) and having an adhesive force that decreases in response to an external stimulus, the electronic component (70) that is adhered to the adhesive resin layer (A) of the

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

adhesive film (50), and a support substrate (80) that is adhered to the adhesive resin layer (B) of the adhesive film (50); a prebake step for heating the structure (100); and a sealing step for sealing the electronic component (70) by means of a sealing material (60).

(57) 要約: 基材層(10)と、基材層(10)の第1面(10A)側に設けられ、かつ、電子部品(70)を仮固定するための粘着性樹脂層(A)と、基材層(10)の第2面(10B)側に設けられ、かつ、外部刺激により粘着力が低下する粘着性樹脂層(B)と、を備える粘着性フィルム(50)と、粘着性フィルム(50)の粘着性樹脂層(A)に貼り付けられた電子部品(70)と、粘着性フィルム(50)の粘着性樹脂層(B)に貼り付けられた支持基板(80)と、を備える構造体(100)を準備する準備工程と、構造体(100)を加熱するプリベーク工程と、封止材(60)により電子部品(70)を封止する封止工程と、を少なくとも備える電子装置の製造方法。